

深圳市信维通信股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

一、报告期内公司从事的主要业务

公司使命：致力于通过对基础材料、基础技术的研究，创造出值得信赖的创新产品与解决方案，为我们的客户创造价值。

报告期内，公司主营业务为射频元器件，主要包括：天线、无线充电模组、射频材料、EMI\EMC器件、射频连接器等，产品可广泛应用于移动终端、汽车、基站端、智能家居等领域。

公司通过自主研发和投资并购，与国内、外知名大学和科研院所合作，持续加大对基础材料、基础技术的研究，以材料驱动业务发展，不断深化“材料->零件->模组”的一站式研发创新能力，为客户提供更丰富的产品和解决方案，在射频技术领域保持行业领先地位。

二、经营情况概述

2020年，公司实现营业收入639,363.83万元，较上年同期增长24.53%；归属于上市公司股东的净利润97,240.63万元，较上年同期减少4.66%。报告期内，受全球疫情影响，公司料、工、费占收入比重有所增加，同时由于短期内人民币升值幅度较大导致汇兑损失加大、本期股权激励摊销费用较大等，公司全年净利润表现受到一定影响。此外，部分客户的部分新产品上市推迟、部分国内客户受外部环境变化影响等，对公司销售收入的增长幅度也产生一定影响。从全年业务发展来看，公司无线充电、5G天线等业务快速成长，EMI/EMC业务稳步增长，LCP、UWB、BTB/RF-BTB等新业务处于投入期，整体生产经营保持柔性、平稳、向好的发展势头。

报告期内，公司持续坚持对基础材料和基础技术的研究，打造技术驱动型企业。2020年度，公司研发投入60,980.69万元，占营业收入比重9.54%。公司中央研究院持续加强在全球各地研发中心的建设，在已设立的中国深圳、中国常州、美国圣地亚哥、日本新横滨、瑞典斯德哥尔摩等前沿研发中心基础上，新增设立日本筑波研究院，进一步加大对高分子材料、陶瓷材料等的研究。目前，在分子聚合物材料领域，公司已形成“LCP材料->LCP天线->LCP模组”一站式解决

方案能力，并将通过对LCP生产线的搭建逐步实现相应产品量产的能力；在磁性材料领域，公司纳米晶、非晶、3D铁氧体性能优异，已大量应用于出货给国内外大客户的无线充电产品中，硬磁材料也得到了大客户的认可，有望进一步提升无线充电等产品的竞争力；在陶瓷材料领域，公司相关储备已覆盖5G毫米波天线、被动元件等产品领域，产品性能已具竞争力；在功能复合材料领域，公司的UWB天线与模组技术水平行业领先，正在多个领域和国内外多家一线厂商联合开发相应产品的应用。此外，报告期内公司积极搭建电阻产品的研发与制造能力，高端被动元件作为公司战略规划的重要方向之一，公司未来还将逐步布局电容和电感等领域，全面进军高端被动元件产业。

截至2020年12月31日，公司已申请专利1583件；2020年新增申请专利372件，其中5G天线140件，LCP专利21件，BAW专利21件，SAW专利12件。随着5G通信技术在可穿戴设备、智能手机、物联网等应用终端的渗透，公司将积极把握产品创新周期，保持对高分子材料、磁性材料、陶瓷材料、新型射频材料等基础材料的前沿研究，加强5G天线、UWB模组、无线充电、LCP模组、高性能精密BTB连接器、5G基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖，推动5G毫米波天线产品的落地，进行了6G相关技术的预研，不断提升竞争力，为客户创造价值。

未来，公司通过持续的研发投入，以每年8%以上研发投入占比的目标，不断引进优秀人才，拓宽公司的技术护城河，扩大公司技术优势，增加客户的粘性，成为具有全球技术竞争力的企业。

在业务拓展方面，公司坚持大客户平台建设，凭借基础材料和基础技术的优势，更前瞻、更深度地参与大客户的新产品项目，不断拓展与客户业务合作的深度与广度。报告期内，公司加快各项产品在大客户的开拓。公司无线充电在客户端的供应份额持续提升，下游应用从手机端拓展至无线耳机、手表等IoT产品应用领域，产品类型也从接收端拓展至发射端，磁性材料的核心能力得到客户认可，公司竞争优势得到进一步扩大，产品应用将向更广泛的领域拓展；公司5G天线、LCP模组等业务推进顺利、客户粘性提升，具备为客户提供从材料到工艺到模组一站式解决方案的能力，未来将进一步扩大客户的覆盖面及已有客户的市场份额；公司高性能精密BTB连接器业务进一步实现了对国内、外主流品牌终端厂商的突破与拓展，已向国内外客户批量供货；此外，公司不断挖掘各项业务的协同性，充分利用自身的资源积累及品牌优势，拓展更多新项目开发的合作机会，其

中UWB天线与模组已正和多家客户开展多种应用的产品开发，电阻产品的研发与制造能力也已快速搭建完成，业务范围也将会逐步向高端被动元件领域深入拓展，而新的业务将会为公司带来更多新的增长机会。

公司将持续重视与全球大客户的良好合作，一方面推动现有项目份额的继续提升，另一方面挖掘新项目、新客户的合作机会，在全球市场范围内不断拓展业务发展。同时持续加大对基础材料和基础技术的研究与投入，打造技术驱动型企业，确保技术领先性，保持整体经营规模的增长势头。此外，随着经营规模的扩大，公司将不断加强对各项业务的整合、协作，通过持续完善企业各项运营管理措施、加大产品的材料和零部件自制力度等，逐步优化各项经营管理成效指标。

三、报告期内董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共召开9次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

- 公司第四届董事会第四次会议于2020年1月19日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
 - 2、审议通过了《关于公司拟增资德清华莹的议案》
 - 3、审议通过了《关于全资子公司拟对外投资的议案》
- 公司第四届董事会第五次会议于2020年3月1日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
 - 2、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
 - 3、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
 - 4、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
 - 5、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
 - 6、审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2020-2022年）的议案》
 - 7、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报与填补回报措施及相关主体承诺的议案》

- 8、审议通过了《董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》
- 9、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 10、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
- 11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 12、审议通过了《关于授权相关人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
- 13、审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
- 公司第四届董事会第六次会议于 2020 年 4 月 16 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于公司<2019 年度董事会工作报告>的议案》
 - 2、审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及其摘要的议案》
 - 3、审议通过了《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》
 - 4、审议通过了《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》
 - 5、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
 - 6、审议通过了《关于公司 2019 年内部控制自我评价报告的议案》
 - 7、审议通过了《关于公司 2019 年社会责任报告的议案》
 - 8、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
 - 9、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
 - 10、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 - 11、审议通过了《关于回购注销股权激励计划部分限制性股票的议案》
 - 12、审议通过了《关于公司减少注册资本的议案》
 - 13、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
 - 14、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
 - 15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
 - 16、审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
 - 17、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》
- 公司第四届董事会第七次会议于 2020 年 7 月 9 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

- 2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
- 3、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
- 4、审议通过了《关于全资子公司为公司提供担保的议案》
- 公司第四届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 5 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于公司<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》
 - 2、审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》
 - 3、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
- 公司第四届董事会第九次会议于 2020 年 9 月 9 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
 - 2、审议通过了《关于深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》
 - 3、审议通过了《关于深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》
 - 4、审议通过了《关于深圳市信维通信股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》
 - 5、审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
 - 6、审议通过了《深圳市信维通信股份有限公司董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》
 - 7、审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》
- 公司第四届董事会第十次会议于 2020 年 10 月 21 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于第三期股权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》
 - 2、审议通过了《关于调整第三期股权激励计划股票期权行权价格的议案》
- 公司第四届董事会第十一次会议于 2020 年 10 月 28 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于公司<2020 年第三季度报告>的议案》
- 公司第四届董事会第十二次会议于 2020 年 12 月 10 日在公司会议室召开。
 - 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及为全资子公司提供授信担保的议案》
 - 2、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

- 3、审议通过了《关于拟签订〈合作框架协议〉的议案》
- 4、审议通过了《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
- 5、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

四、公司未来发展的展望

（一）2021 年发展展望

2021 年，公司将继续积极面对极具挑战的外部环境，打造技术驱动型企业，这就要求公司必须持续深化内功。公司将坚持对基础材料、基础技术的研发创新投入，在巩固原有业务领域优势的基础上，通过给客户提供高附加值的新产品，确保公司在客户端的竞争力。同时，公司重点关注应收账款周转率等财务指标的提升、改善，需进一步加强内部运营及预算管理等能力，增加抗风险能力，降本增效，实现公司经营业绩的持续增长。

1、面对 5G 通信发展的机会，充分把握移动终端、汽车、基站端、智能家居等领域的业务机会，提前做好技术路径的预研，做好国内、外大客户的产品配套服务。

2、在技术研发储备方面，以研发投入占比 8%以上为目标，持续加大基础材料和基础技术的研究，在日本已有 2 个材料研究院的基础上，计划继续在日本新增 1 个材料研究院，加大对高分子材料、陶瓷材料、磁性材料等核心材料的研究；加大对被动元件的建设投入，快速搭建电阻产品的研发与制造能力，全面进军高端被动元件产业；加快 5G 毫米波天线的产品落地工作；进一步扩大 5G 天线、UWB 模组、无线充电、LCP 模组、高性能精密 BTB 连接器、5G 基站天线及关键天线部件等产品的客户覆盖和市场份额；继续开展 6G 相关技术的预研。

3、在客户合作方面，提升与客户在战略层面的合作，需进一步加强对客户痛点、技术发展趋势、竞争对手动向的收集和分析，强化销售端-中央研究院-事业部的内部协同，加快新产品、新技术在客户端的推广落地。

4、在团队建设方面，需在核心岗位的能力培养和人才引进上花大力气，让

更多有能力、有冲劲的年轻人来建设组织、完善组织；积极推进共识、共创、共担、共享的合伙人文化，加大对奋斗者、贡献者的激励。

5、公司通过全面的预算管理加强对各事业部的管控，严格执行费用预算，实现降本增效；加快资金周转速度，提高资金使用效率，合理安排资金的使用，保障公司稳步健康的发展。

2021年，注定是充满挑战的一年，也是充满机会和期待的一年。公司不忘初心，坚定对基础材料、基础技术的研究，拓宽技术的护城河，公司希望成为“卓越运营+产品领先”的企业，力争为全体股东带来长期良好回报。

（二）2021年公司发展面临的挑战及应对措施

公司未来整体业绩表现的不确定因素及应对措施如下：

1、经营风险

①外部经济变化的影响

目前，国内外经济形势复杂多变，特别是外部经济摩擦等，都会给企业的生产经营及发展预期带来一定的不确定性，经济环境的变化会给公司的经营产生一定的影响。针对此风险，公司一方面加深与合作，做好客户及市场变化的预判，争取更多的市场份额，同时也加大对新产品、新技术的研发投入，加大重要客户新产品的营收占比，培育新的收入增长点；另一方面，公司除了维持在消费电子移动终端领域的领先优势，也积极开拓基站端和 IOT 应用领域的业务布局及产品开发，降低外部经济变化对公司经营业绩的影响。

②行业形势的变化

消费电子行业具备创新周期短、产品迭代快的特征，下游需求不断变化，只有不断推出有创新力的产品，才能不被市场淘汰。公司坚持高研发投入，并通过持续的研发投入来保证产品在技术上的领先性。公司作为泛射频行业的领军企业，在主要产品生产规模和工艺技术方面具有较强的市场竞争能力，显现出良好的发展前景，但公司如在行业整合过程中未能在生产、管理、营销、技术等方面持续占据竞争优势，未来将面临一定的市场竞争风险。

③汇率波动的不确定性

公司出口销售和进口原材料以美元结算为主，随着国际政治经济环境的不稳定性提升，公司会面临汇率波动的不确定性。未来，公司会加强外汇管理，做好

外汇汇率波动的前瞻性预测，提前做好相关的风险对冲准备，降低汇率波动对公司的影响。

2、管理风险

近年来，随着业务的不断拓展，公司内生式增长与外延式发展同步进行，公司子公司、参股公司增多，产品线愈发丰富，公司员工人数相应增长，现有管理制度及管理体系面临诸多新挑战。如果公司管理层对公司现行治理架构、内部管理流程和人员结构的调整完善无法适应公司快速发展的需要，将使公司管理风险增大。

公司管理层已充分意识到在快速发展的过程中可能存在一定的管理风险，这就要求公司需进一步对现有管理架构进行完善与优化，加强对子公司、参股公司管理团队合规运营理念的宣导，定期开展系统性的管理培训，严格执行内控与预算管理，做好公司整体战略计划的贯彻落实。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二一年四月二十三日